



Compression Molding System

Model CPM1150series



**Compression molding system specialized
for high-density package molding**



高密度パッケージ成形に特化した コンプレッションモールド装置

- 次世代の狭ギャップ構造に対応し、HBM4などの高密度実装向けに最適
- 微細ギャップへのMUF充填に適した成形プロセスを採用
- 独自開発のコンプレッション技術を核に、ウェハレベルモールドとパネルレベルモールドを実現
- 1台の装置で顆粒樹脂と液状樹脂に対応 ※CPM1150-HPは顆粒樹脂と液状樹脂の選択式
- 独自の均一樹脂散布とパターンディスペンスに対応
- プレスモジュールの増減による生産数量の変化への対応

CPMseries
Wafer typeCPMseries
Panel type

CPM1080-HP

SPECIFICATION

Items		Unit	Description					
モデル		—	CPM1150-V			CPM1150-HP		
ワークタイプ		—	パネル・ウェハ					
ワークサイズ	パネル	mm	□150—320					
	ウェハ	mm	φ 320 (Max.)					
樹脂		—	顆粒・液状（併用可）			顆粒 or 液状（選択式）		
マシンタイム		sec	Approximately 88			Approximately 65		
外形寸法	プレス数	module	1	2	1	2	3	4
	幅	mm	3,910	4,590	5,490	6,170	6,850	7,530
	奥行き	mm	2,180	2,180	2,168	2,168	2,168	2,168
	高さ	mm	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980
重量		ton	7.0	10.6	10.2	13.8	17.4	21.0
成形取り数		workpiece	1	2	1	2	3	4
マガジンスペース		—	Panel : Input / Output 2 cassette each Wafer : 2 loadport					
クランプ出力		kN/(tf)	98.0—1,470.0 / 10.0—150.0					
クランプ速度		mm/sec	50 (Max.)					
リリースフィルム幅		mm	440 (Max.)					

- ・上記数値は当社標準機の場合です。
- ・改良のため仕様を変更する事があります。
- ・特殊システム仕様についてはご相談ください。
- ・外形寸法は顆粒樹脂仕様のものに記載しています。

TOWA株式会社

【本社・工場】

〒601-8105 京都府京都市南区上鳥羽上調子町5番地

【海外販売拠点】

■中国

- ・TOWA (Shanghai) Co., Ltd.
- ・Hechuang Semiconductor Equipment (Shenzhen) Co., Ltd.

■台湾

- ・TOWA Taiwan Co., Ltd.

■韓国

- ・TOWA Korea Co., Ltd.

■シンガポール

- ・TOWA Asia-Pacific Pte. Ltd.

■マレーシア

- ・TOWA Malaysia Sales & Services Sdn. Bhd.

■タイ

- ・TOWA THAI COMPANY LIMITED

■フィリピン

- ・TOWA Semiconductor Equipment Philippines Corp.

■インド

- ・TOWA SEMICONDUCTOR INDIA PRIVATE LIMITED

■ドイツ

- ・TOWA Europe GmbH

■オランダ

- ・TOWA Europe B.V.

■アメリカ

- ・TOWA USA Corporation

